OSPI 3311M

Flux de brasage sans halogènes et sans nettoyage pour l'OSP

Description:

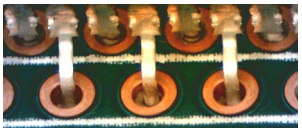
Interflux® **OSPI 3311M** est un flux sans nettoyage spécialement développé pour des circuits avec la finition OSP (cuivre passivé) qui ont vécu un ou plusieurs process de refusion et pour des productions de brasage à hautes cadences.

Le flux OSPI 3311M est une version optimalisée du flux OSPI 3311 pour la formation de résidu et pour l'odeur.

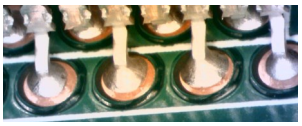
La plupart des finitions OSP se dégradent très vite après la refusion, ce qui rend le mouillage et les remontées d'alliage avec le brasage à la vague ou le brasage sélectif un vrai défi, certainement avec les alliages sans plomb.

Le flux OSPI 3311M a été développé afin d'améliorer la brasabilité et les remontées d'alliage sur ces finitions OSP dégradées, surtout avec des vitesses de production élevées et un préchauffage bas.

En plus, le flux est absolument sans halogènes et il a été développé pour être fiable. Il est conforme aux exigences IPC.



Flux standard sur OSP dégradé



OSPI 3311M sur OSP dégradé

La photo n'est pas contractuelle

RoHS compliant

Avantages

- Très bonne brasabilité sur l'OSP dégradé
- Pour des productions à hautes cadences
- Approprié pour des grandes vitesses de production
- Absolument sans halogènes
- Brasage avec plomb et sans plomb
- Formation de résidu après le brasage réduite
- Odeur réduite

Propriétés chimiques et physiques

Apparence	Liquide incolore
Matière solide	5.3% +/- 0.5%
Présence d'halogènes	Aucune
Densité à 20°C	0.825 g/ml ±0.01
Indice d'acide	42 mg KOH/g ±5
Odeur	Alcool
IPC/EN	OR/L0

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com

CERTIFIED QUALITY SYSTEM ISO 9001

Remontées d'alliage

Pour les circuits en cuivre passivé, suffisamment de flux, une température de préchauffage modérée et une pression haute de la première vague peut bénéficier les remontées de la soudure dans les trous métallisés.

Application du flux

Fluxeur spray: Il est recommandé d'utiliser un spray qui fluxe la carte à l'aller et au retour. Maintenir une pression d'air basse. Régler la vitesse de déplacement de la buse de façon que chaque point soit fluxé deux fois (une fois de chaque côté). Ainsi les bandes de fluxage se chevauchent à 50% de leurs largeurs et la meilleure répartition possible du flux est obtenue. Utiliser un carton, en lieu et place d'une carte, pour vérifier l'homogénéité du dépôt de flux. Retirer le carton de la machine avant le préchauffage. En complément du carton utiliser une plaque de verre ou un circuit nu qui permet d'évaluer la quantité de flux déposé. Retirer-les de la machine avant le préchauffage. Il ne devrait pas avoir de gouttes de flux en dessous. Les gouttes sont difficiles à évaporer et sont une indication de trop de flux. Réduire la quantité de flux jusqu'à ce que des défauts typiques pour une quantité de flux trop basse, comme des courts circuits, 'stalactites',...apparaissent. Après, augmenter la quantité jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

Préchauffage

Le flux a été développé pour bien se comporter avec un préchauffage bas: 80°C-100°C (176°-212°F) côté composants est recommandé. Un préchauffage plus haut est possible pour des circuits avec une grande masse thermique. Plus de préchauffage peut améliorer les remontées d'alliage pour ces circuits mais il faut faire attention de ne pas détériorer le flux. Le flux seul n'as pas une limite inférieure pour le préchauffage pourvu que les solvants soient totalement évaporés avant le contact avec la vague.

Pente de préchauffage: 1-3°C/s

Contact vague(s)

En simple vague, le temps de contact standard est de 3-4s. En double vague, le temps de contact standard de la première vague est de 1-2s et de 2-4s pour la deuxième vague. Le contact minimal est de 2s. Un temps de contact plus court peut donner un bon résultat de brasage mais un temps de contact plus important aura l'avantage de bien éliminer le flux lors du contact vague(s). La limite maximale du temps de contact sera déterminée par la détérioration du flux et les propriétés physiques de la carte et des composants. Les indications pour la détérioration du flux sont l'apparition des ponts, 'stalactites', soudure sur le vernis épargne,...

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com

Résultats des tests de fiabilité

Conformes aux normes EN 61190-1-2(2002) et IPC J-STD-004A

Tests	Résultats	Méthodes
Chimique		
Classification du flux	**ORL0**	J-STD-004A
Miroir de cuivre	**passe**	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes		
Chromate d'argent (Cl, Br)	**passe**	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33D
Tache de fluor (F)	**passe**	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35.1A
Quantité d'halogènes	**0,00%**	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35C
Environnement		
Test SIR	**passe**	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3B

Manipulation

Stockage

Le flux doit être stocké dans les bidons d'origines fermés, à des températures entre de +5° à +25°C

Sécurité

Le flux OSPI 3311M est inflammable. S'il vous plaît, toujours lire la fiche de sécurité du produit.

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com

Conditionnement

Le flux OSPI 3311M est disponible en conditionnement suivant:

Bouteille HDPE de 1L

Bidons HDPE de 10L et de 25L
Fût HDPE de 200L

Autre conditionnement disponible sur demande

Nom commercial du produit: OSPI 3311M No-Clean Soldering Flux

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS N.V.

la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V - Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium
tel.: +32 9251 49 59 - fax.: +32 9251.4970
www.interflux.com - Info@interflux.com